

**113 年度工研院機械與機電系統研究所
車用傳動、智慧自動化、綠色製造、半導體光電
及智慧機器人技術等相關專利讓與暨專屬授權案**

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強而有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與或專屬授權之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與/專屬授權標的：

- （一）本案件包含專利 60 案 100 件（以下簡稱：「本案件標的」）。
- （二）「本案件標的」無共有專利。「本案件標的」相關資訊詳如附件。
- （三）投標廠商得依實際需求，就「讓與模式」及/或「專屬授權模式」參與投標。惟本案件以「讓與模式」作為「本案件標的」之優先運用方式，若「讓與模式」有流標、廢標或無效投標者，始進行「專屬授權模式」之開標審議等程序；若「讓與模式」及「專屬授權模式」均流標、廢標、無效投標或未通過相關主管機關之核准者，工研院得另洽第三人為專屬授權或讓與等交易行為。

四、公開說明會與領標：

- （一）公開說明會將於民國（下同）114 年 1 月 9 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。
- （二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 114 年 1 月 8 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「113 年度工研院機械與機電系統研究所車用傳動、智慧自動化、綠色製造、半導體光電及智慧機器人技術等相關專利讓與暨專屬授權案-公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 114 年 1 月 8 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
- （三）自本案件公告日起至截標日 114 年 1 月 20 日 17 時整（含）止，得

洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

(一) 本案件採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1. (密封)價格封。
2. 押標金。
3. 公司設立證明文件(如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)。
4. 近兩年財報資料。(如新創公司成立未滿兩年，請檢附成立迄今之財報資料。)
5. 公司基本資料暨運用規劃說明表。
6. 商業營運計畫書一式 7 份。(若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。)(前述全部資料文件等，以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「113 年度工研院機械與機電系統研究所車用傳動、智慧自動化、綠色製造、半導體光電及智慧機器人技術等相關專利讓與暨專屬授權案」，於截標日 114 年 1 月 20 日 17 時整(含)前(以送達收據為憑)掛號寄達或親送至：

31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 桂小姐 收。

(二) 廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表及商業營運計畫書中詳細敘明，並於公司基本資料暨運用規劃表敘明境外實施金額。

(三) 商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司背景／關係企業／合作夥伴簡介(20%)
2. 公司財務狀況(20%)
3. 公司營運／研發能力(20%)
4. 「本案件標的」運用規劃(30%)
5. 國內產業效益(10%)

(如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等)

(四) 投標方式：本案件採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。
(「本案件標的」以同一發明為一案。)

(五) 本案件不得共同投標或就同一模式重複投標，但就不同模式(即「讓與模式」或「專屬授權模式」)得分別投標。

(六) 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

(七) 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

- (一) 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。於決標當日依「八、決標方法」第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起 10 個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）。
- (二) 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
- (三) 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

- (一) 投標時間截止後之投標。
- (二) 開標前業已公告停止本案件交易程序。
- (三) 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
- (四) 投標單附加任何成交條件者。
- (五) 「投標文件」之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
- (六) 「投標文件」有所缺漏者。但押標金不足或商業營運計畫書份數不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於複審前未能補足者，其投標為無效。
- (七) 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果（包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果）轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。
- (八) 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方法：

- (一) 本案件以「讓與模式」作為「本案件標的」之優先運用方式，「讓與模式」於流標、廢標或無效投標後，始進行「專屬授權模式」之決標審議等程序；「讓與模式」之決標方式須通過初審（114 年 2 月 11 日）及複審（114 年 2 月 18 日）程序，「專屬授權模式」亦須經初審（114 年 2 月 11 日）及複審（114 年 2 月 18 日）程序，投標廠商於通過初審後，始能進入複審。工研院會另行通知通過初審之投標廠商依通知時間進行複審。
- (二) 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。
- (三) 初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、近兩年財報資料、商業營運計

畫書、價格封等進行形式審查及確認。

- (四) 投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會就商業營運計畫書、價格等進行複審，投標廠商於複審時應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。
- (五) 投標廠商若有境外實施需求，除應依「五、投標方法」第(二)點敘明外，並應於複審時報告說明。
- (六) 複審時，工研院開標審議委員會將同時開啟超過及格分之所有投標廠商價格封，將以投標金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商有一次優先加價機會，若此優先加價仍無超過底價，之後則由超過及格分之所有投標廠商同時議價，議價次數以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二(含)家以上超過及格分之投標廠商之投標金額超過底價且相同，得提供該投標廠商議價機會，並以高價者得標。議價次數以三次為限，經三次議價後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。(議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書)
- (七) 開標時將請律師到場監標。
- (八) 開標結果依政府法令相關規定，須向主管機關呈報者，則於主管機關同意後始生效力。
- (九) 工研院將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標廠商)。
- (十) 對於「讓與模式」及「專屬授權模式」均流標、廢標或無效投標之「本案件標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。

九、契約事項：

- (一) 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」。「讓與契約書」/「專屬授權契約書」原則上應具備「九、契約事項」所載之條件；但基於產業運用效益等考量，雙方得於「讓與契約書」/「專屬授權契約書」中另議合法合規之條件，工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」與否之權利。
- (二) 得標廠商如無正當理由屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為專屬授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。
- (三) 得標廠商與簽訂「讓與契約書」/「專屬授權契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院

得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。

- (四) 遵守政府法令規定：得標廠商就「本案件標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
- (五) 得標廠商應支付工研院讓與/專屬授權費用，讓與/專屬授權費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
- (六) 得標廠商簽署「讓與契約書」/「專屬授權契約書」且生效時，本案件簽約保證金移充為之讓與/專屬授權費用。「讓與契約書」經雙方依法簽章報經濟部同意後生效，得標廠商充分了解「本案件標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。「專屬授權契約書」自其所載生效日起生效，「授權標的」之授權期間自「專屬授權契約書」生效日起 10 年，惟專利有效期間早於前述期間者，該專利授權期間則以其專利有效期間為準。
- (七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「本案件標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部及/或工研院。得標廠商嗣後若將「本案件標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。
- (八) 得標廠商應就「本案件標的」之一部或全部，容忍於「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效前：
 - 1. 工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；
 - 2. 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；
 - 3. 工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。
- (九) 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」/「專屬授權契約書」僅為工研院同意讓與/專屬授權「本案件標的」予得標廠商。工研院亦僅依本案件公告日之「本案件標的」現狀讓與/專屬授權得標廠商，工研院不擔保「本案件標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「本案件標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「本案件標的」所製造產品之產品責任。「本案件標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「本

案件標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效後，「本案件標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「本案件標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「本案件標的」之諮詢講解或訓練之義務。

(十) 「本案件標的」之讓與/專屬授權登記手續全權由工研院依工研院作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與/專屬授權登記手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效之日起負擔「本案件標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「本案件標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

(十一) 「本案件標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部產業技術司，下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：

1. 得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
2. 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
3. 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；
4. 得標廠商讓與「本案件標的」之對象非我國研究機構或企業者。

(十二) 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」，並得將「本案件標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「本案件標的」收歸國有：

1. 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「本案件標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
2. 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「本案件標的」者。

3. 為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

- (十三) 得標廠商如將「本案件標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」/「專屬授權契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。
- (十四) 若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與、專屬授權、輾轉讓與或專屬授權「本案件標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「本案件標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與「後手」之讓與契約，否則即視為得標廠商已將「本案件標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」，工研院得依前述約定行使相關權利。
- (十五) 得標廠商應使所有「後手」遵守「九、契約事項」第七項至第九項、第十一項至第十七項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。
- (十六) 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「本案件標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院並取得書面同意。得標廠商於「讓與契約書」/「專屬授權契約書」生效後對第三人就「本案件標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。
- (十七) 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後30日內，應以書

面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」/「專屬授權契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」或以書面另議新約。

- (十八) 得標廠商應盡力進行產品開發等運用「本案件標的」工作，若得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「本案件標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」/「專屬授權契約書」或將「本案件標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本案件公告為「讓與契約書」/「專屬授權契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本案件公告、「本案件標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本案件公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 桂小姐。

電話：(03) 591-8009，傳真：(03) 582-0466。

電子信箱：ManTing@itri.org.tw。

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

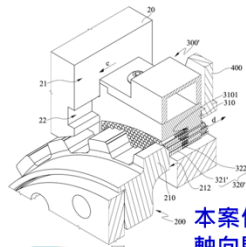
附件一：本案件標的簡介

(歡迎產業界針對有興趣之標的報名公開說明會了解相關資訊。)

本案標的說明：車用傳動技術

產業趨勢及專利布局規劃

- 傳統車輛為燃油動力，傳動系統需有變速裝置與換向控制機構，隨著混合動力與電動車市場需求增加，車用傳動發展主流朝向**電動化傳動**、**AI輔助自駕控制**、**馬達驅控決策**等方向佈局。本案推廣技術為變速箱用駐車與換向機構等，可運用於傳統內燃機與電動車輛之傳動與變速系統。



2000年~2010年

- 燃油引擎技術
- 電控變速箱
- 電控傳動機構

本案代表專利：
軸向駐車機構
藉由軸向多重制動機構
駐車車可在任何角度鎖定

- TW I598523
- US 10054224
- CN ZL201611003864.4

2010年~2020年

- 油電混合技術
- 馬達驅控
- 電池技術

2020年~

- AI自駕
- 多馬達驅控
- 高電壓電能系統

本專利群布局於2010~2019年(4案7件)

- 傳動齒輪加工
- 傳動換向機構與施力轉移
- 駐車機構

本案標的說明：智慧自動化技術

產業趨勢及專利布局規劃

- 過去工廠採取機電整合自動化，隨著市場需求不確定性及客製化產品需求增加，工廠發展主流朝向**數位化與智慧製造**，因此持續朝向**視覺+AI輔助智動化**、**自主決策**、**AI/GAI應用**等方向佈局。

~2011

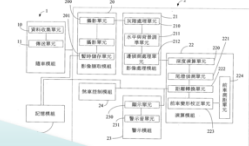
- 機電整合自動化、定位及控制
- 機械、組件結構設計
- 2D視覺輔助智動化、線上檢/量測
- 2.5D視覺離線檢/量測
- 虛擬量測
- 設備預兆診斷

2011~2019

- 視覺(2D/3D)輔助智動化
- 智動化整形
- 3D視覺取放、檢/量測
- 3D視覺+複合功能
- 虛擬檢/量測
- 安全輔助

2020~

- 視覺+AI輔助智動化
- 複材成型、生醫智動化
- 組裝配適、智慧調適、自主決策
- 2D/3D視覺+AI、AI品質預測
- GAI生成應用
- 自律製造(智能設備+數位雙生)



本專利群布局於 2015~2016年 (3案 4件)

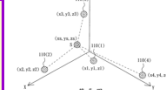
- 連桿機構、機器人工作平台以及機器人工作平台的設計方法 (2015 TW)
- 電子裝置與其電源管理方法 (2015 TW)
- 自動追蹤防撞警示系統及其方法 (2016 TW I530409、US 9399463)

本專利群布局於 2008~2009年 (2案 2件)

- 聲源定位系統及聲源定位方法 (2008 TW I327230)
- 超音波加工機之主軸及其撓性鉸鍊 (2009 TW)

原應用於機器人聽覺辨位，隨著波束成型及AI技術成熟，其應用性已逐漸降低，但於安全監測、智慧家庭等低成本應用上仍有良好的效果。

原應用於行車安全(車距)輔助預警，因目前自動跟車、煞車力道輔助等已成為主動式系統標配，雖應用機會較小，但在安全監測應用上(如物體接近警示)仍有不錯的應用價值。



本案標的說明：綠色製造技術

2016

2033

網版印刷膜及其表面改質方法：CIGS電池、Si晶太陽電池 (TW I523592)

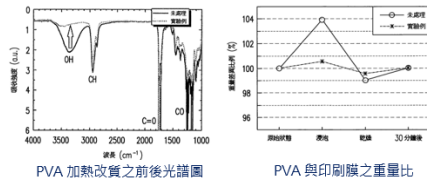
氧化鋅抗反射層與其製法：CIGS電池、Si晶太陽電池 (TW I525229 ; US 9261627)

➤ 相關特色專利介紹(3案4件)・專利布局期間：2016年~2033年

1. 網版印刷膜及其表面改質方法 (1案1件)

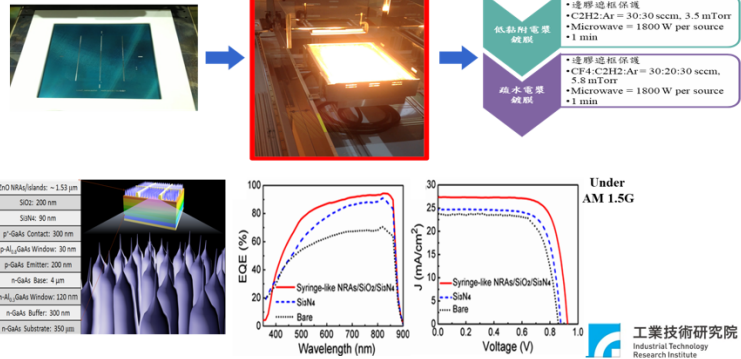
壓印裝置(1案1件)

應用: 表面光滑疏水鍍層



2. 氧化鋅抗反射層與其製法 (1案2件)

應用: 自潔淨鍍層、抗反射鍍層



本案標的說明：綠色製造技術

2014/2015

2032/2034

超導材料的接合方法：風力發電機、磁浮列車 (TW I458145 ; US 8808492 ; CN ZL201210181157.X ;

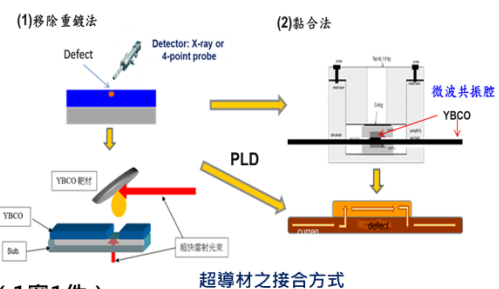
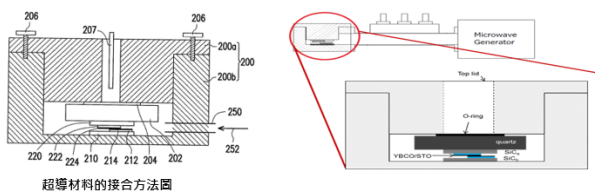
JP 5568612 ; KR 10-1379865)

超導薄膜的缺陷修補方法、鍍膜方法與以此方法製作的超導薄膜：風力發電機、磁浮列車 (TW I488994)

➤ 相關特色專利介紹 (2案6件)・專利布局期間：2014年~2034年

1. 超導材料的接合方法 (1案5件)

應用: 超導、陶瓷、玻璃材料接合



2. 超導薄膜的缺陷修補方法、鍍膜方法與以此方法製作的超導薄膜 (1案1件)

應用: 超導、陶瓷、玻璃材料的缺陷修補

本案標的說明：綠色製造技術

產業演進與專利佈局規劃-車輛製造/工程車

FY105~110

適應於不同車型不同種類加裝掃具裝置

- 油壓設備
- 快拆設計、卡扣

~FY105

為方便車斗或其他裝置可穩定加裝

- 車載掃具設計

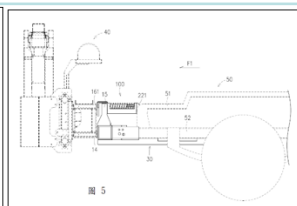
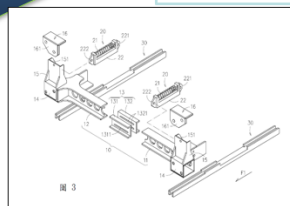
FY110~

智能自動化、並定義統一車載規範

- 電動智能化、安全規範

本專利群布局於 2017~2018年 (2案4件)

- 接合裝置及應用其的工程車輛 (CN ZL201621227441.6、TW M538934)
- 適用於工具車輛的工具架接模組 (CN ZL201711223729.5、TW I620679)



- 原應用於環保車在安裝不同掃具時可做為快速拆換之新型機構。
- 應用於車斗快速拆接機構，將可延伸於其他領域之快拆機構。

本案標的說明：半導體光電技術

產業趨勢及專利布局規劃-半導體鍍膜製程設備技術

2008

電漿輔助沉積技術
• PECVD鍍膜方法

2013

薄膜封裝技術
• ALD薄膜沉積
氣體噴灑模組技術
• ALD設備模組、腔體

2014

2021

沉積設備方法及裝置
• 新穎ALD鍍膜封裝技術

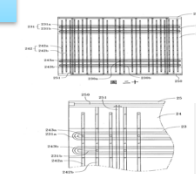
2022

2026

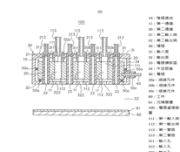
沉積速率回控技術
高深寬比薄膜監控技術

本專利群布局於 2006~2015年(22案32件)

- 霧化方式及其控制方式
- 電漿處理裝置
- 噴灑頭模組
- 面型蒸鍍源方法與其系統
- 具照明成像裝置及相關取放機構
- 鍍薄膜沉積方法及系統及電漿頭
- 疏水結構與其製法



氣體噴灑模組：I437622

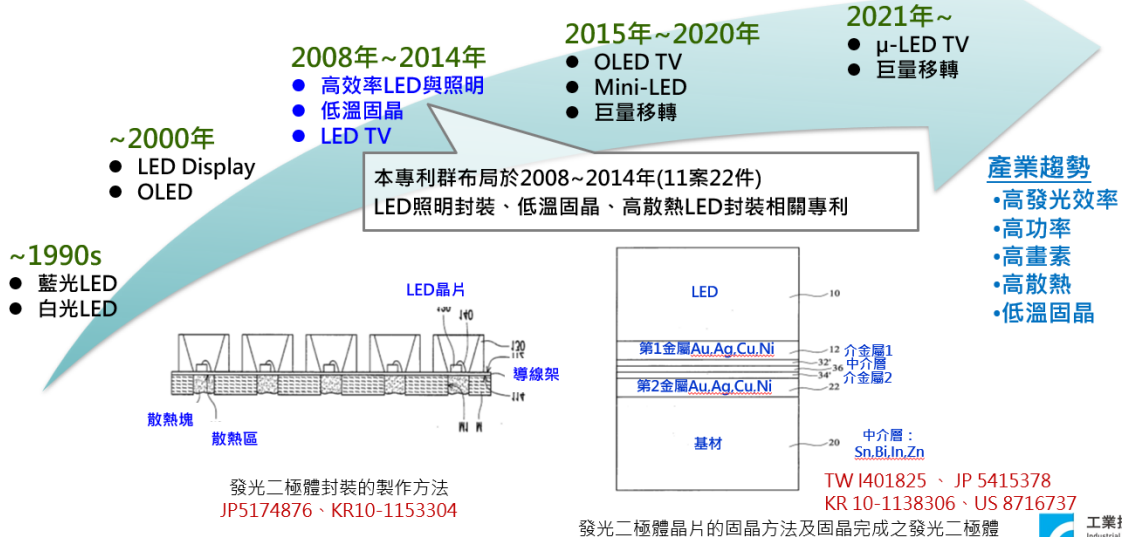


電漿處理裝置：I427183

- 正當光電元件產品朝向精細、線寬微形及尺寸大型化，高密度電漿/原子層/PEALD沉積等技術已漸成為研發應用主流，然而，氣體噴灑模組及電漿處理裝置等，目前仍有新興市場及後段製程等鍍膜發展需求，故此等專利是具有不錯應用之潛在機會。

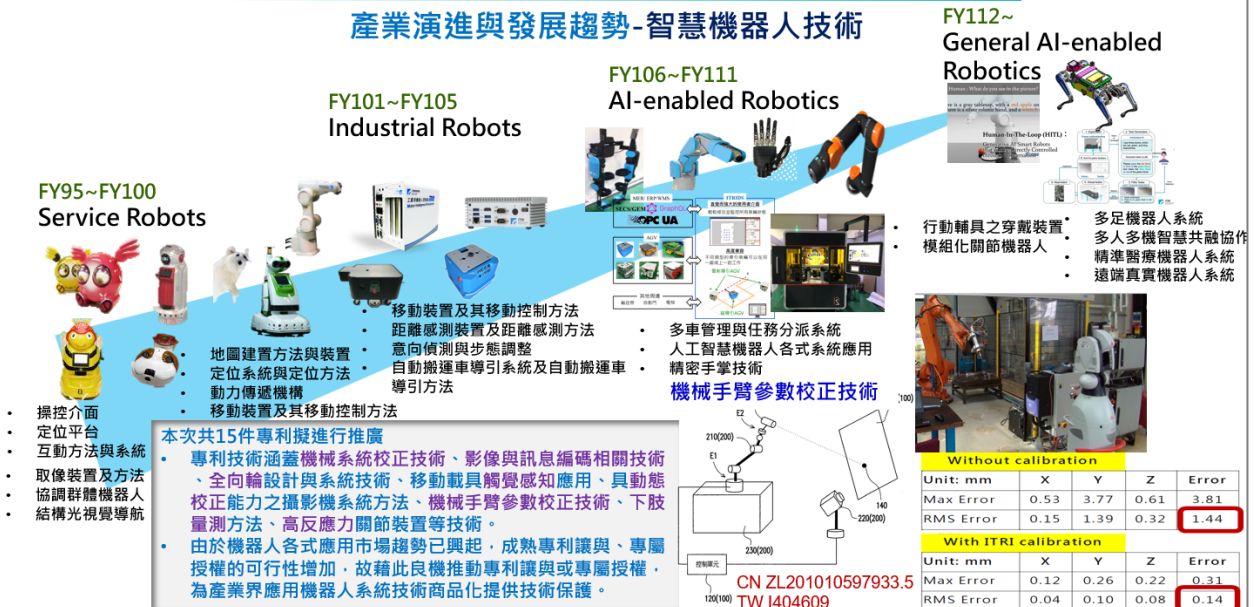
本案標的說明：半導體光電技術

產業趨勢及專利布局規劃-發光LED封裝技術



本案標的說明：智慧機器人技術

產業演進與發展趨勢-智慧機器人技術





附件二：專利清單

(一) 車用傳動：4 案 7 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
1	1	P53010049TW	具有移動方向切換之載具	中華民國	獲證	TWI471243	20150201	20321015	工研院	工研院	
2	2	P53020061TW	施力轉移裝置	中華民國	獲證	TWI541188	20160711	20331024	工研院	工研院	
3	3	P53040056CN	減振裝置及其所使用的研磨減振模塊與滾刀減振模塊	中國大陸	獲證	CN106695468	20190604	20351206	經濟部產業技術司	工研院	
	4	P53040056TW	減震裝置及其所使用的之研磨減震模組與滾刀減震模組	中華民國	獲證	TWI580526	20170501	20351111	經濟部產業技術司	工研院	
4	5	P53050021CN	軸向駐車機構	中國大陸	獲證	CN107956867	20190614	20361114	經濟部產業技術司	工研院	
	6	P53050021TW	軸向駐車機構	中華民國	獲證	TWI598523	20170911	20361013	經濟部產業技術司	工研院	
	7	P53050021US	軸向駐車機構	美國	獲證	US10054224	20180821	20370424	經濟部產業技術司	工研院	

(二) 智慧自動化：5 案 6 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
5	8	P53020020TW	連桿機構、機器人工作平台以及機器人工作平台的設計方法	中華民國	獲證	TWI566904	20170121	20331111	經濟部產業技術司	工研院	
6	9	P53020027TW	電子裝置與其電源管理方法	中華民國	獲證	TWI475371	20150301	20330912	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
7	10	P53030022TW	自動追蹤防撞警示系統及其方法	中華民國	獲證	TWI530409	20160421	20341106	經濟部產業技術司	工研院	
	11	P53030022US	自動追蹤防撞警示系統及其方法	美國	獲證	US9399463	20160726	20350104	經濟部產業技術司	工研院	
8	12	P53950134TW	聲源定位系統及聲源定位方法	中華民國	獲證	TWI327230	20100711	20270402	經濟部產業技術司	工研院	
9	13	P53960104TW	超音波加工機之主軸及其撓性鉸鍊	中華民國	獲證	TWI337559	20110221	20271219	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權

(三) 綠色製造：9 案 18 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
10	14	P53000055TW	壓印裝置	中華民國	獲證	TWI447315	20140801	20311107	經濟部能源署	工研院	
11	15	P53000069CN	超導材料的接合方法	中國大陸	獲證	CN103178422	20151021	20320603	經濟部能源署	工研院	
	16	P53000069JP	超導材料的接合方法	日本	獲證	JP5568612	20140627	20320909	經濟部能源署	工研院	
	17	P53000069KR	超導材料的接合方法	韓國	獲證	KR101379865	20140325	20320711	經濟部能源署	工研院	
	18	P53000069TW	超導材料的接合方法	中華民國	獲證	TWI458145	20141021	20311219	經濟部能源署	工研院	
	19	P53000069US	超導材料的接合方法	美國	獲證	US8808492	20140819	20321002	經濟部能源署	工研院	
12	20	P53000092TW	氧化鋅抗反射層與其製法	中華民國	獲證	TWI525229	20160311	20311117	經濟部產業技術司	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
12	21	P53000092US	氧化鋅抗反射層與其製法	美國	獲證	US9261627	20160216	20330530	經濟部產業技術司	工研院	
13	22	P53020004TW	網版印刷膜及其表面改質方法	中華民國	獲證	TWI523592	20160221	20330721	經濟部產業技術司	工研院	
14	23	P53020099TW	超導薄膜的缺陷修補方法、鍍膜方法與以此方法製作的超導薄膜	中華民國	獲證	TWI488994	20150621	20340416	經濟部能源署	工研院	
15	24	P53030011CNC1	靜電式氣體清淨機	中國大陸	獲證	CN106140475	20190903	20350427	工研院	工研院	曾專屬授權
	25	P53030011TWC1	靜電式氣體清淨機	中華民國	獲證	TWI572831	20170301	20350408	工研院	工研院	曾專屬授權
16	26	P53050032CN	接合裝置及應用其的工程車輛	中國大陸	獲證	CN206289569	20170630	20261114	經濟部產業技術司	工研院	
	27	P53050032TW	接合裝置及應用其之工程車輛	中華民國	獲證	M538934	20170401	20261031	經濟部產業技術司	工研院	
17	28	P53060043CN	適用於工具車輛的工具架接模組	中國大陸	獲證	CN109720159	20201030	20371128	經濟部產業技術司	工研院	
	29	P53060043TW	適用於工具車輛的工具架接模組	中華民國	獲證	TWI620679	20180411	20371030	經濟部產業技術司	工研院	
18	30	P53980110CN	無油潤滑離心式冷媒壓縮機及其潤滑方法	中國大陸	獲證	CN102155429	20130724	20300211	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	31	P53980110TW	無油潤滑離心式冷媒壓縮機及其潤滑方法	中華民國	獲證	TWI386611	20130221	20300209	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權

(四) 半導體光電：33 案 54 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
19	32	P53060009TW	雙光學量測補償系統	中華民國	獲證	TWI648516	20190121	20371101	經濟部產業技術司	工研院	
20	33	P53060036TW	元件擴距轉移方法及實施此轉移方法的設備	中華民國	獲證	TWI694605	20200521	20380805	經濟部產業技術司	工研院	
	34	P53060036US	元件擴距轉移方法及實施此轉移方法的設備	美國	獲證	US10510287	20191217	20380805	經濟部產業技術司	工研院	
21	35	P53970005CN	真空設備之基座定位支撐裝置	中國大陸	獲證	CN101591771	20110316	20280529	經濟部能源署	工研院	
	36	P53970005TW	真空設備之基座定位支撐裝置	中華民國	獲證	TWI371823	20120901	20280515	經濟部能源署	工研院	
22	37	P53970016CN	電容耦合式射頻電漿源	中國大陸	獲證	CN101770922	20110803	20281230	經濟部能源署	工研院	
23	38	P53970044TW	薄形易脆基材傳輸裝置	中華民國	獲證	TWI363035	20120501	20281112	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
24	39	P53980026TW	氣體分佈板及其裝置	中華民國	獲證	TWI385272	20130211	20290924	經濟部能源署	工研院	
25	40	P53980079CN	微晶矽薄膜的沉積方法及等離子體輔助沉積的監控裝置	中國大陸	獲證	CN102108494	20130116	20291222	經濟部能源署	工研院	
26	41	P53980102TW	氣體噴灑模組及其氣體噴灑掃描裝置	中華民國	獲證	TWI369251	20120801	20300131	經濟部能源署	工研院	
27	42	P53990011TW	表面處理裝置及其方法	中華民國	獲證	TWI432600	20140401	20300610	經濟部能源署	工研院	
28	43	P53990040TW	均勻磁場產生設備及其磁場產生單元	中華民國	獲證	TWI384510	20130201	20301111	經濟部能源署	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
29	44	P04940058CNC1	疏水結構及其制法	中國大陸	獲證	CN100494472	20090603	20261116	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	45	P04940058TWC1	疏水結構及其製法	中華民國	獲證	TWI322833	20100401	20260926	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
30	46	P53000010JP	一種碲薄膜沈積方法及系統及其電漿頭	日本	獲證	JP5519727	20140411	20320510	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
31	47	P53000088TW	一種電磁波偏振元件	中華民國	獲證	TWI435125	20140421	20311229	經濟部能源署	工研院	
32	48	P53000091CN	霧化裝置及其控制方法	中國大陸	獲證	CN103157565	20160120	20320617	經濟部產業技術司	工研院	
	49	P53000091TW	霧化裝置及其控制方法	中華民國	獲證	TWI538742	20160621	20311215	經濟部產業技術司	工研院	
33	50	P53000100US	具照明之成像裝置及其鏡盒	美國	獲證	US8672501	20140318	20321023	經濟部產業技術司	工研院	
34	51	P53020023TW	具有弧形載盤之旋轉定位裝置、自動取放系統及其操作方法	中華民國	獲證	TWI499684	20150911	20330818	經濟部產業技術司	工研院	
35	52	P53020048TW	大氣電漿前趨物供料裝置	中華民國	獲證	TWI480416	20150411	20331119	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
36	53	P53020050TW	發光裝置	中華民國	獲證	TWI511338	20151201	20331216	經濟部能源署	工研院	
37	54	P53950127TW	包含壓力與溫度感測器之人工皮膚	中華民國	獲證	TWI309195	20090501	20270320	經濟部產業技術司	工研院	
38	55	P53960052CN	光源裝置	中國大陸	獲證	CN101452917	20130220	20271204	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
	56	P53960052TW	光源裝置	中華民國	獲證	TWI353053	20111121	20271127	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
39	57	P53970008CN	一種太陽能集光模塊	中國大陸	獲證	CN101740652	20120215	20281123	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	58	P53970008TW	太陽能集光模組	中華民國	獲證	TWI382551	20130111	20281105	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
40	59	P53970045CN	氣體分布噴灑模塊	中國大陸	獲證	CN101748384	20120711	20281202	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
	60	P53970045DE	氣體噴灑模組	德國	獲證	DE102009000903	20150528	20290215	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
	61	P53970045JP	氣體噴灑模組	日本	獲證	JP4971376	20120413	20290118	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
	62	P53970045TW	氣體噴灑模組	中華民國	獲證	TWI437622	20140511	20281125	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
41	63	P53970055JP	大氣電漿大幅寬處理裝置	日本	獲證	JP4965609	20120406	20290810	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
42	64	P53970057TW	導光裝置以及窗戶	中華民國	獲證	TWI349734	20111001	20281225	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
43	65	P53970084JP	立體式發光二極體封裝方法與結構	日本	獲證	JP5058237	20120810	20291029	經濟部能源署	工研院	
	66	P53970084KR	立體式發光二極體封裝方法與結構	韓國	獲證	KR101117590	20120210	20291126	經濟部能源署	工研院	
	67	P53970084TWC2	發光二極體照明模組與封裝方法	中華民國	獲證	TWI401788	20130711	20290928	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
44	68	P53980008CN	低溫形成反射性發光二極管固晶接合結構的方法	中國大陸	獲證	CN101950782	20130109	20290709	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
	69	P53980008TW	低溫形成反射性發光二極管固晶接合結構之方法	中華民國	獲證	TWI381562	20130101	20290625	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
45	70	P53980044JP	發光二極體封裝的製作方法	日本	獲證	JP5174876	20130111	20300921	經濟部能源署	工研院	
	71	P53980044KR	發光二極體封裝的製作方法	韓國	獲證	KR101153304	20120530	20300823	經濟部能源署	工研院	
46	72	P53980069JP	發光二極體晶片的固晶方法及固晶完成之發光二極體	日本	獲證	JP5415378	20131122	20300815	經濟部能源署	工研院	
	73	P53980069KR	發光二極體晶片的固晶方法及固晶完成之發光二極體	韓國	獲證	KR101138306	20120413	20300819	經濟部能源署	工研院	
	74	P53980069TW	發光二極體晶片的固晶方法及固晶完成之發光二極體	中華民國	獲證	TWI401825	20130711	20291126	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
	75	P53980069USD1	發光二極體晶片的固晶方法及固晶完成之發光二極體	美國	獲證	US8716737	20140506	20300810	經濟部能源署	工研院	
47	76	P53980099CN	面型蒸鍍源及其蒸鍍方法與系統	中國大陸	獲證	CN102477538	20150610	20301220	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	77	P53980099JP	薄膜平面型連續式蒸鍍源及製造方法與系統	日本	獲證	JP5496929	20140314	20310208	經濟部產業技術司	工研院	
	78	P53980099TWC1	一種面型蒸鍍源及其蒸鍍方法與系統	中華民國	獲證	TWI452157	20140911	20301125	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
48	79	P53990017CN	發光二級管芯片固晶方法、固晶的發光二極管及芯片結構	中國大陸	獲證	CN102104090	20140319	20301007	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
	80	P53990017TW	晶片結構	中華民國	獲證	TWI489596	20150621	20300720	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
49	81	P53990023CN	發光二極管模塊製造方法以及該發光二極管模塊	中國大陸	獲證	CN102563448	20130925	20310105	經濟部能源署	工研院	
	82	P53990023TW	發光二極體模組製造方法以及該發光二極體模組	中華民國	獲證	TWI425616	20140201	20301222	經濟部能源署	工研院	
50	83	P53990033TW	LED 晶圓之接合方法、LED 晶粒之製造方法及 LED 晶圓與基體之接合結構	中華民國	獲證	TWI446577	20140721	20301222	經濟部能源署	工研院	曾非專屬授權
51	84	P53990045CN	等離子體處理裝置	中國大陸	獲證	CN102477547	20141210	20301208	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	85	P53990045TW	電漿處理裝置	中華民國	獲證	TWI427183	20140221	20301124	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權

(五) 智慧機器人：9 案 15 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
52	86	P53010050US	影像與訊息編碼系統、編碼方法、解碼系統及解碼方法	美國	獲證	US9336609	20160510	20340524	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
53	87	P53020034TW	下肢量測與補償系統與方法	中華民國	獲證	TWI552725	20161011	20331121	工研院	工研院	
54	88	P53020044CN	盤匣式螺絲取放裝置	中國大陸	獲證	CN104440746	20160406	20330923	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
55	89	P53040009CN	機械系統的校正及監測裝置	中國大陸	獲證	CN106355614	20190531	20351223	經濟部產業技術司	工研院	
	90	P53040009TW	用於機械系統校正及監測的裝置與方法	中華民國	獲證	TWI609750	20180101	20351108	經濟部產業技術司	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
55	91	P53040009US	機械系統的校正暨監測裝置	美國	獲證	US10547796	20200128	20380215	經濟部產業技術司	工研院	
56	92	P53950072TW	全向輪及使用此全向輪的車輛載具	中華民國	獲證	TWI325379	20100601	20261227	經濟部產業技術司	工研院	
57	93	P53950085CN	可動裝置	中國大陸	獲證	CN101211190	20100519	20261224	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	94	P53950085TW	觸覺感知裝置以及使用該裝置之可動裝置	中華民國	獲證	TWI306054	20090211	20261218	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
58	95	P53970082JP	具動態校正的攝影機及其動態校正方法	日本	獲證	JP5177760	20130118	20290422	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
	96	P53970082TW	具動態校正的攝影機及其動態校正方法	中華民國	獲證	TWI408486	20130911	20281229	經濟部產業技術司	工研院	曾非專屬授權
59	97	P53990024CN	機械手臂系統參數的校正方法與校正裝置	中國大陸	獲證	CN102452081	20140319	20301219	經濟部產業技術司	工研院	
	98	P53990024TW	機械手臂系統參數的校正方法與校正裝置	中華民國	獲證	TWI404609	20130811	20301020	經濟部產業技術司	工研院	
60	99	P53990030TW	高反應力關節裝置的控制方法	中華民國	獲證	TWI401144	20130711	20300930	經濟部產業技術司	工研院	
	100	P53990030US	高反應力關節裝置的控制方法	美國	獲證	US8616088	20131231	20311226	經濟部產業技術司	工研院	

【備註】本案件公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。